

2024年深圳集成电路展会时间、地点、报名方式

产品名称	2024年深圳集成电路展会时间、地点、报名方式
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024深圳国际集成电路展览会

2024 Shenzhen International Integrated Circuit Expo

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

集成电路(简称IC、芯片)作为信息技术的核心,是支撑社会经济发展和国家安全的战略性、基础性和先导性产业,已广泛渗透与融合到国民经济和社会发展的每个角落,是《中国制造2025》的重要组成部分,是实现数字中国和智慧社会发展战略的支撑力量。集成电路已经在各行各业中发挥着非常重要的作用,是现代信息社会的基石。随着5G、人工智能、物联网、无人驾驶等新兴科技的快速发展,我国IC产业呈现出新一轮创新活力。在市场拉动和政策支持下,我国集成电路产业快速发展,整体实力显着提升,已经成为全球规模大、增速快的集成电路市场,随着数字中国和智慧社会战略目标的加快推进,国家促进集成电路产业政策环境不断完善,以协同创新、开放合作、智能应用、深度融合为特征的中国集成电路产业正呈现出全新格局,产业平稳快速增长,技术创新持续活跃,兼并重组不断深入,产融结合日益密切,市场需求广泛拓展,国际联动发展显著。国家集成电路产业投资基金撬动作用显现,地方性基金相继设立,有效带动一批重点项目投资。伴随全球集成电路产业进入深度调整与转折期,中国集成电路产业将迎来实现“华丽转身”的重要机遇期。

深圳作为我国规模超大、整体水平较高的电子信息产业的重要基地之一,是全国较具影响力的集成电路应用市场。深圳的集成电路产业多年来一直保持高速增长,特别是IC设计产业一直位于全国前列。产业集群优势凸显,在无人机、汽车电子、安防、物联网、手机、消费及穿戴电子、家电、电源、5G通信等有着数万家企业聚集。芯片半导体产业应用优势明显。为促进集成电路行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流,2024深圳国际集成电路展览会将于2024年4月9-11日在深圳会展中心盛大举办,展会隶属于第十二届中国电子信息博览会专题展之一,专注于为集成电路企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台,助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的集成电路产业品牌盛会,展会遵循市场发展趋势,给集成电路行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用,把脉行业发展方向。共享国际化大平台,共拓集成电路大市场,让我们携手同行,共创商机,共同推动中国IC产业创新发展!

展品范围

集成电路产品:模拟集成电路、数/模混合集成电路,包括微处理器、存储器、FPGA、分立器件、光电器件、功率器件、传感器件等主流产品和技术。

集成电路制造:芯片制造、封装测试、半导体专用设备和材料。

集成电路应用:人工智能、物联网、智慧城市、智能家居、智能终端、汽车电子、LED、健康医疗等智能化应用类。

展会优势

高效供需对接平台——超10,000+的全产业链集成电路行业相关观众将赴展会现场与国内外品牌实现对接。

同期展会——CITE 2024第十二届中国电子信息博览会是展示全球电子信息产业新产品和技术的平台,经过十一年努力,现已经成为亚洲规模大、产业链全、活动内容丰富、影响力提升快的电子信息展览会,也是行业具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

全媒体渠道曝光——包含百度、360搜索、神马搜索、搜狗搜索四大搜索引擎,微信公众号、微博、搜狐、头条等自媒体平台,DOUYIN、微信视频号、腾讯、爱奇艺等视频资源全媒体主要平台推广曝光,为品牌提高度,加速品牌从同行中脱颖而出。

展会亮点

科技协同创新:发挥粤港澳大湾区城市群效应,为产业链打造创新升级环境,实现从“世界工厂”向

“广东创造”转变，建设成新一代集成电路产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握集成电路产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外集成电路产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题引爆。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE-ELE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

微处理器的内部结构是如何的？

16位微处理器（图中为8086微处理器）可分成两个部分，一部分是执行部件(EU)，即执行指令的部分；另一部分是总线接口部件(BIU),与8086总线联系，执行从存储器取指令的操作。微处理器分成EU和BIU后,可使取指令和执行指令的操作重叠进行。EU部分有一个寄存器堆,由8个16位的寄存器组成,可用以存放数据、变址和堆栈指针、算术运算逻辑单元(ALU)执行算术运算和逻辑操作,标志寄存器寄存这些操作结果的条件。执行部件中的这些部件是通过数据总线传送数据的。总线接口部件也有一个寄存器堆,其中CS、DS、SS和ES是存储空间分段的分段寄存器。IP是指令指针。内部通信寄存器也是暂时存放数据的寄存器。指令队列是把预先取来的指令流存放起来。总线接口部件还有一个地址加法器,把分段寄存器值和偏置值相加,取得20位的物理地址。数据和地址通过总线控制逻辑与外面的8086系统总线相联系。8086有16位数据总线,处理器与片外传送数据时,一次可传送16位二进制数。8086具有一个初级流水线结构,可以实现片内操作与片外操作的重叠。